DERWENT-ACC-NO:

1983-42241K

DERWENT-WEEK:

198318

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Semiconductor ceramics for ceramic

capacitor - consists

of barium oxide, titania, rare earth

metal oxide, and

oxide(s) of chromium, manganese,

iron, cobalt and/or

nickel. NoAbstract

PATENT-ASSIGNEE: MATSUSHITA ELEC IND CO LTD [MATU]

PRIORITY-DATA: 1981JP-0148646 (September 18, 1981)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE ]

PAGES

MAIN-IPC

JP 58048908 A

March 23, 1983

N/A

005

JP 88028492 B

N/A

June 8, 1988

N/A

000 N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP 58048908A

N/A

1981JP-0148646

September 18, 1981

INT-CL (IPC): C04B035/46, H01B003/12, H01B017/62,

H01G004/12

ABSTRACTED-PUB-NO:

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

DERWENT-CLASS: L03 V01 X12

CPI-CODES: L02-G07C; L03-B03B;

## (9) 日本国特許庁 (JP)

# ⑫公開特許公報(A)

①特許出願公開

昭58—48908

⑤Int. Cl.³
 H 01 G 4/12
 // H 01 B 3/12
 17/62

識別記号

庁内整理番号 2112-5E 43公開 昭和58年(1983)3月23日

発明の数 3 審査請求 未請求

(全 10 頁)

砂表面誘電体層型半導体磁器組成物およびその 製造方法

②特

頭 昭56-148646

20出

願 昭56(1981)9月18日

⑫発 明 者 和田達也

新加田達也 門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

**@発 明 者 松尾嘉浩** 

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

@発 明 者 藤村正紀

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑩発 明 者 池辺庄一

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

個代 理 人 弁理士 中尾敏男 外1名

明 細 書

1、発明の名称

表面誘電体層型半導体磁器組成物およびその製造方法

2、特許請求の範囲

(2) 含有 $TiO_2$ 成分のモル量の5ち含有BaO 成分のモル量に対応するそれと等しい $TiO_2$ 成分のモル量を被じた残りの $TiO_2$ 成分のモル量が、含

有 Ln 一酸化物 (LnO<sub>3/2</sub>) 成分のモル量の 1.5 倍であることを特徴とする特許請求の範囲第1項 記載の表面誘電体層型半導体磁器組成物。

(3) 酸化パリウム (BaO) 成分が49.16~41.38

モル 8、酸化チタン (TiO2) 成分が 50.17~51.72 モル 8, および、希士類元素酸化物 (LnO3/2) 成分 0.67~6.90 モル 8 (ただし Lnは Nd, Pr および La の 9 ちの少なくとも つつ、 La の合有量が希土類元素全体の 20原子 8 以下)の組成比率からなる組成物に対して、 5 り 化 Cr, Mn, Fe, Co および Ni の各酸化物の 9 ち 少なくとも一つを合量で 5 原子 8 を超えない量合 有している 半導体磁器の表面に誘電体層が形成されていることを特徴とする表面誘電体層半導体磁器 組成物 o

(4) 含有TiO2成分のモル量のうち含有BaO 成分のモル量に対応するそれと等しいTiO2成分のモル量を減じた役りのTiO2成分のモル量が、含有Ln 一酸化物(LnO3/2)成分のモル量の1.5倍であることを特徴とする特許請求の範囲第3項

記載の表面誘電体層型半導体磁器組成物。
(5) 炭酸バリウム (BaCO<sub>3</sub>)成分が49.16~41.38 モル \* 、酸化チタン (TiO<sub>2</sub>) 成分が50.17~ 51.72 モル \* 、および、酸化ネオジウム (NdO<sub>3/2</sub>)と酸化プラセオジウム (PrO<sub>11/6</sub>) と酸化ランタン (LaO<sub>3/2</sub>) の各成分の合量が

O.77~6.90 モルダ(ただしLa 成分量が上記

希土類元素成分の全量に対して20原子多以下)

の組成比率からなる組成物に対して、さらにCr、Mn,Fe,CoかよびNiの各酸化物のうち少なくとも一つを合量で5原子がを超えない量添加してなる圧粉成形体を、酸化性雰囲気中において1250~1450 での範囲内の温度で焼結させ、得られた誘電体磁器を選元性雰囲気中にかいて900~1260 での範囲内の温度で加熱処理して酸素やいて800~1200 での範囲の温度で加熱処理して、おいて800~1200 での範囲の温度で加熱処理して再酸化し、それにより磁器表面を誘電体化するとを特徴とする表面誘電体層型半導体磁器組成物の製造方法。

って、要望される材料は、面積容量が大きく、かつ,容量の電圧依存性の少ないものが望ましい。

本発明の目的は面積容量が 0.1 μF/cnl以上、絶縁破壊電圧が 500V以上の特性を同時に満し、さらに面積容量の電圧依存性の小さいコンデンサ素子を提供することにあり、特に固溶体の最適組成比(希土類元素 Ln の最適含有量),最適製造処理条件を選んだ場合には少なくとも 0.27μF/cnl以上の面積容量をもつコンデンサ素子を提供することにある。

発明者らはBaTiO3-Ln2/3TiO3 系固溶体について、Lnの種類(La,Ce,Pr,Nd,Sm,Eu,Gd,Dy),固溶体の超成比を検討した結果、それぞれの希土類元素Lnについて最適組成比が存在し、程度共通した最適製造処理条件が存在することがわかった。さらに、Lnの最適組成比がよび最適製造処理条件において、Pr,Nd,Sm,Eu,Gd,Dyのぞれぞれを使用やたときに得られるコンデンサ素子の面積容量が、Laの場合の面積容量の.27μP/cd(絶縁破線電圧800V)に比

#### 3、発明の詳細な説明

本発明はBaTiO3-Ln2/3TiO3-系固溶体(ただし、Ln は希土類元素)にCr,Mn,Fe,Co,およびNi の各酸化物の 5 ちーつ以上を添加含有させた半導体磁器の表面層を誘電体化した磁器組成物に関する。

敏近、磁器コンデンサに対して小型大容量が強く要望されており、さらに面積容量の大きい材料が要望されている。しかし、一般に表面誘電体層型半導体コンデンサは表面層のどく薄い誘電体層を利用しているため、電圧印加による静電容量および絶縁抵抗の減少がみられることがあり、この場合、低い使用電圧に限定されてしまう。したが

較してそれぞれ 1.5 倍, 2 倍, 2 倍, 1.8 倍, 1.5 倍, 1.3 倍 ( なお絶縁破壊電圧は 750~850 V のレベル) になることを発見した。ただし、Ce の場合の面積容量は La の場合に比較してむしろ小さかった。さらに市版の安価な工業用原料である机・酸化ネオジウム ( Nd 86.6%, Pr 27.1%, La 5.12%, Sm 1.16%, Ce 0.01%, その他 O.01%) を使用したときの面积容量は La の場合の面積容量に比較してやは り約 2 倍になることを見出した。たとえば単位面積当りの容量が 0.58 ルド/パー、電気絶縁破壊電圧 ( Vet ) 820 Vの特性をもつコンデンサが得られた。

一般に、表面誘電体層型半導体磁器は、チタン酸がリウム(BaTiO3)とチタン酸希土類( $Ln_2/3$ TiO3,ただしLn は希土類元素)との2 成分系固溶体を基体とし、それぞれの成分比を(1-x)対xとすると、この固溶体は( $Ba_1-xLn_2x/3$  $\square_x/3$ ) $TiO_3$  なる化学式で表わされる。この固溶体はベロプスカイト型構造のBa 位置に電気的中性の格子欠陥を持っているのが特徴である。こ

特開昭58- 48908(**3**)

の中性格子欠陥は、固溶させた希土類元素 Ln の 最(2×/3)の半分の量(×/3)だけ常に生成す る。 この中性格子欠陥は高温での酸素イオン空孔 の生成を容易にし、したがって酸素イオンの体積 拡散を促進するいちぢるしい効果を持っている。 したがって、このような Ba 位置に中性格子欠陥 を持ったベロブスカイト型構造固溶体は、次のよ うな特徴を持つ。

- (1) 焼結性がよく、緻密な磁器が得られる。
- (2) 粒子内部の酸化凝元速度は粒界の酸化凝元速度と同程度に大きい。

特に(2)の効果は、半導体磁器の表面全域に誘電体層が形成されている本発明の表面誘電体層型半導体磁器を作製する上に不可欠である。また(1)の効果は表面誘電体層の絶縁破壊電圧を高める上に重要である。

このように、重要な Ba 位置中性格子欠陥をペップスカイト型固溶体中に導入するには、(1-x)  $BaTiO_3-xLn_2/3$  O 1/3 Ti  $4+O_3$  の組成からなる固溶体粉末を焼結させる場合、それを酸化性

(LuはLa, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy) 采固溶体からなる誘電体磁器のキュリー点を室温(26℃)まで移動させる  ${\it C}$  必要な固溶量  ${\it C}$  と、その時のキュリー点での誘電 ${\it C}$   ${\it C}$ 

Lnの種類	固溶量ェ	Lnの酸化物 含有量(モル%)	キュリー点 (で)	25でにおける と。
La	0.06	2.05	25	8000
Ce	0.07	2.40	25	7500
Pr	0.08	2.7 4	25	12000
Νd	0.08	2.7 4	25	15000
Sm.	0.08	2.7 4	25	16000
Eu	0.07	2.40	25	14000
Gď	0.06	2.05	25	12500
Dу	0.06	2.05	25	10000

雰囲気中で行なりことが必須条件となる。もしも 避元性雰囲気中で焼結させると、上配組成物は (Ba1-2y/3la2y/3)Ti<sup>3+</sup>2y/3<sup>O</sup>3の固溶 体と少量のTiO2との2成分になり、しかもこの 生成した固溶体はBa位置中性格子欠陥を持って いない。したがって、この固溶体では酸素イオン 空孔が生じにくく、故に粒子内部での酸化量元速 度が遅く、本発明の目的である表面誘電体層型半 導体磁器を得るには不適当である。

酸化性雰囲気中たとえば空気中において 1250 c 以上の温度で焼結させて得られた Ba 位置中性 欠陥を持った固溶体からなる誘電体磁器の誘電率 の温度変化を測定すると、Ln の量によってキュリー点が低温側に移動するとともに、キュリー点での誘電率 ( $\mathcal{E}_c$ ) の大きさも変化する。 この挙動は 布土類元素の種類によって異なる。 各希土類元素を用いて、 キュリー点をたとえば室温(25c) に移動させたときの $\mathcal{E}_c$  の値を第1表に示す。

第 1 表 (1-x)BaTiO<sub>3</sub>-xLn<sub>2/3</sub>TiO<sub>3</sub>

の面積容量が約2倍になる理由の一つである。 と こで1250でよりも低い温度では、これらの固容 体は十分に焼結せず、不適当であり、また、1450 で以上の温度での焼結は試料間の融着,変形など が起るため製造上不適当である。

次に、このような1250で以上で過焼成を生じない温度で酸化性雰囲気中(空気中)にて焼結させた誘電体磁器を選元性雰囲気中において900~1200での範囲内の温度で加熱処理すると、酸素イオン空孔型半導体磁器が得られる。この半導性間溶体の化学組成は(Ba1-xLn2x/3)まで表わされる。ここで、1250でより高い温度での加熱処理は、Ti3+の生成,Ba位置中性格子欠陥の減少が起るので、好ましくない。また、900でより低い温度での加熱処理は、確性を与える酸素イオン空孔(①)の生成が少なく、磁器が半導体化しないので、好ましくない。したがって、上記誘電体磁器を900~1250での範囲内の温度で30分以上加熱処理すると、磁器内部まで一様に半導体化する。

次に、このようにして得られた酸素イオン空孔 型半導体磁器を、酸化性雰囲気中において800~ 1200c の範囲内の温度で加熱処理する。このと き、酸素イオン空孔型半導体磁器の表面から順次 酸化されて誘電体になって行く。この酸素イオン 空孔型半導体磁器の表面に形成される誘電体層の 厚みは、酸化性雰囲気中の加熱処理の温度と時間 に依存する。たとえば0.92BaTiO3-0.08 (Ndo.7Pro.3)2/3TiO3磁器を1000でで1 時間酸素気流中において熱処理すると、その誘電 体層の厚みは14μm 程度になる。温度が高い程、 また熱処理時間が長い程、この厚みは増加するo 1200c よりも高い温度では再酸化が進みすぎて、 誘電体層が厚くなりすぎる。これによって面積容 量がいちぢるしく減少するので好ましくないo ま た、800℃よりも低い温度の熱処理では再酸化速 度が遅くなり、処理時間が長くかかりすぎて量産 的でないので好ましくない。

上配の例では、片面で誘電体層の厚みが14 µm であるから両面では28μm の厚みになり、この

点はさらに低温側に移動し、室温での誘電率は結 果的に低下する。 Ln- 酸化物の含有量が 6.90 モルダよりも多くなると、面積容量がいちぢるし く減少し、本発明の目的である O.1 μ F/c/i以上の 面積容量が得られなくなる。

さらに、希土類元素の組成比および製造処理条 件が最適である場合の本発明の目的の一つである 面積容量が 0.27μF/cml 以上の大きいコンデンサ 素子を得るためには、←。(キュリー点=25℃) を小さくする La,および Ce の含有量は希土類元 素 Ln の全含有量に対して20原子のを超えては ならないo すなわち、La あるいはCe の含有量 がLn の全含有量に対して20原子を軽えると、 Ln 一酸化物の含有量が2.05~2.74モルラの最 適組成比範囲の固溶体であっても、また製造処理 条件が最適であっても、面積容量 O.27μF/cml 以 上、絶縁破壊電圧 500V以上のコンデンサを得る ととができなくなるので、好ましくない。

上記BaTiO3-Ln2/3TiO3 固密体にMn, Fe,Ni,CrおよびCo の酸化物の少なくとも一 ときの面積容量は0.53 μF/cm である。

前述したように、このBaTiO3-Ln2/3TiO3 系固裕体においては、旅加した Ln の量の平分だ けのBa位置中性格子欠陥が存在し、この中性格 子欠解が高温での酸素イオン空孔の生成を助け、 酸素イオンの体積拡散を促進するが、含有Ln-酸化物量が 0.67 モルダよりも少ないとき、 Ba 位置中性格子欠陥量が少なく、酸化還元速度が遅 く、製造上好ましくない(むしろ粒界誘電体層型 K近くなる)o また、Ln- 酸化物の含有量を増 して行くと、生成する Ba 位置中性格子欠陥の量 も増加し、酸化還元の速度も速くなる。また、Ln 一酸化物の含有量を増すと、キュリー点が低温側 KR動して、Ln- 酸化物の含有量が2.05~ 2.74 EN\$ ( Pr, Nd, Sm 12.74 EN\$. Ce, Eu は 2.40 モルダ, La, Gd, Dy は 2.05 モルる)であるときキュリー点が室温付近になり、 このとき、BaTiO3-Ln2/3TiO3 系固密体の 第温での誘棋率は極大を示す。 Ln- 酸化物の含 有量が2.05~2.74 モル多を越えると、キュリー

つを添加含有させると、誘電体層の固有抵抗が高 くなり、一方、酸紫イオン空孔型半導体部分の固 有抵抗はほとんど変らないので、表面誘電体層型 半導体磁器コンデンサの誘電損失が小さくなり、 また絶縁破壊電圧が高くなる。さらに、Mn 酸化 物などの添加効果としては、電圧印加時の面積容 鮮および絶縁抵抗の低下が抑制される。また、印 加電圧を取り去った後の容量の復帰も瞬時に起と る。したがって、より高い電圧下での使用が可能 となる。しかしながら、その添加含有量が5原子 %を越えると、酸素イオン空孔型半導体部分の間 有抵抗も高くなり、表面誘電体層型半導体磁器コ ンデンサの誘電損失、特に高周波での誘電損失が 大きくなるので、好ましくない。また面積容量も Mn などの添加含有量に比例して小さくなる傾向 **にある**。

また、上記BaTiO3-Ln2/3TiO3 固溶体に Si の酸化物、たとえばSiO2の形で添加すると、 Si の添加含有量が O.5 ~ 1.0 原子 5 程度であれ. ば焼結時における磁器の緻密化促進がみられ、絶

持開昭58- 48908(5)

15

縁破壊電圧の向上,誘電損失の低減などの効果があるので好ましいが、その量が原子多を越えると誘電率の低下がいちぢるしく、面積容量 0.27 μF/cm 以上の磁器コンデンサを得ることができなくなるので望ましくない。

このように、本発明のかかる表面誘電体層型半導体型磁器組成物およびその製造方法は、非常に大きい面積容量( 0.1 μF/cml 以上)を有し、高い絶縁破壊電圧( 500V以上)をもち、面積容量の電圧依存性の小さい小型大容量化の要望に沿う半導体磁器コンデンサを提供することができるものである。

以下、実施例をあげて、本発明につき詳細に説明する。

#### 奥施例.1

市販の工業用原料 B a CO<sub>3</sub> 粉末(純度 99.9%以上), T iO<sub>2</sub> 粉末(純度 99.9%以上), また市販の武薬特級 L a <sub>2</sub>O<sub>3</sub>, C e O<sub>2</sub>, P r <sub>6</sub>O<sub>11</sub>, N d <sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Sm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, B u <sub>2</sub>O<sub>3</sub>, G d <sub>2</sub>O<sub>3</sub>, D y <sub>2</sub>O<sub>3</sub> の各粉末(純度はいずれも 99.9 %以上)を用い、下記の

第2表の組成比になるように配合し、ボットとウレタンボールを用いて湿式混合し、乾燥した後、1150℃の温度で4時間仮焼した。 この仮焼物を混式粉砕し、乾燥した後、ボリビニールアルコール水溶液をバインダーにして混合し、32メッシュバーを放射である。 直径13mm 厚さ 0.5mmの円板形に約1トン/cmlの加圧で成温度で2時間焼成して、直径約10.5cm、厚み0.4mmの円板形が電体、で2時間焼成して、直径約10.5cm、厚み0.4mmの円板形が電体、で25分H2混合ガス気流中にないで1050での温度で2時間加熱処理しての強度で加熱処理した。

(以下余白)

故	番号 BaO TiO2	1* 49.3 50.12	2 4216 5017	3 4830 5034	4 4745 5051	0 5 4458 5048	6 45.68 50.86	7 44.80 51.04	8 41.38 51.72	9* 40.13 51.97	11* 49.38 50.12	_
		2 n.5	7 0.67	1.3 6	1 2.0 4	3 274	346	4.16	6.90	7 290	0	
超	NdO3/2 PrO11/6	0		٥	0	0	0		0	0	.0.5	
光 報	Smo	٥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K	Eug.	0	0	0	0	0	o	0	0	0	0	
7 8	GdO, 72	0	0	0	0	0	. 0		. 0	٥	0	
	DyQ.	0	٥	٥	0	0	0	0	0	0	0	
	Smo. Z Eug. 2 Gdog. 2 Dyo. 2 Lacy.		0			-	0	. 0	0	0	0	
l	C <sub>0</sub> O <sub>2</sub>		0	-	-	0	0	ö	0	6	0	

1,72 0 6,90 1,97 0 7,90 0,12 0 0 0,68 0 0 1,72 0 0 1,97 0 0 1,72 0 0 0,17 0 0 0,17 0 0 0,17 0 0 1,72 0 0	4.58	5068	0	2.74	0	0	0	,0		
19**     40.15     51.97     0     790       21**     49.38     50.12     0     0       22     49.16     50.17     0     0       24     46.58     50.68     0     0       28     41.58     51.72     0     0       32     49.16     50.17     0     0       34     47.00     50.47     0     0       42     49.16     50.17     0     0       44     47.44     50.51     0     0       48     41.58     51.72     0     0	1.38	51.72		6.90		0	0	0	0	
24         49.38         50.12         0         0           24         46.58         50.17         0         0           24         46.58         50.68         0         0           28         41.38         51.72         0         0           29*         40.13         51.97         0         0           32         49.16         50.17         0         0           34         47.00         50.60         0         0           42         49.16         50.17         0         0           44         47.44         50.51         0         0           48         41.38         51.72         0         0	0.13	2	٥	290	0	0	0	0	0	
22 49.16 50.17 0 0 0 28 46.58 50.68 0 0 0 0 28 41.58 51.72 0 0 0 27 42.00 50.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		5012	0	0	0.5	. 0	0	0	0	
24     46.58     50.68     0     0       28     41.58     51.72     0     0       29**     40.13     51.97     0     0       32     49.16     50.17     0     0       34     47.00     50.60     0     0       42     49.16     50.17     0     0       44     47.44     50.51     0     0       48     41.38     51.72     0     0	-	3	0	0	0.67	0	0	o	0	
28 41.58 51.72 0 0 0 2.29** 40.13 51.97 0 0 0 0 3.2 4.9.16 50.17 0 0 0 0 3.8 41.38 51.72 0 0 0 4 4 7.44 50.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	$\dashv$	50.68	0	0	2.7 4	0	0	0	0	°
29*     40.13     51.97     0     0       32     49.16     50.17     0     0       34     47.00     50.60     0     0       38     41.38     51.72     0     0       42     49.16     50.17     0     0       44     47.44     50.51     0     0       48     41.38     51.72     0     0		51,72	0	0	0 6 79	0	0	0	. 0	-
32 49.16 50.17 0 0 0 34 47.00 50.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		5 1.9 7	0	0	062	0	0	0	٥	-
34 4700 \$0.60 0 0 38 41.38 \$1.72 0 0 42 49.16 \$0.17 0 0 44 47.44 \$0.51 0 0 48 41.38 \$1.72 0 0		5017	0	0	0	0.67		0		°
38 41.38 51.72 0 0 42 49.16 50.17 0 0 44 47.44 50.51 0 0 48 41.38 51.72 0 0	-	5060	0	. 0	0	2.40	0		0	0
42 49.16 50.17 0 0 0 44 47.44 50.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		51.72	0	0	0	6.90		0		0
44 47.44 50.51 · 0 · 0 48 41.38 51.72 0 0	-	5 Q 1 7	0	0			0.67	0		°
41.38 51.72 0 0	-		0	0 .	0	0	2.05	0	0	0
	$\dashv$	51.72	0	0	0	•	0.6.9	0	0	L

# 持開昭58- 48908(6)

このようにして得られた表面誘電体層型半導体磁器の両面に、銀電極を焼き付けてコンデンサ素子とし、その単位面積当りの容量 C(測定周波数 1kHz)、誘電損失 tan ð(1kHz),絶縁抵抗 I R(測定時の最大印加電圧:直流 5 O V),絶縁破壊電圧 Vb を測定した。その結果を第3表に示す。(以下余白)

_		_			_		,	,						18
٥		6	, c	240		٥	-					۵	٥	
٥	٥	6	20.5	0	0	-		-	0.24	0.50	0.75	0.23	0.47	.071
0.67	2.05	6.90	٥	0		0	٥		0	-			0	0
٥	0	0	0	0		0	0	0.5.9	0	0	0	1.071	0.64	0.54
0	0		0	0	-	0	126	0.59	0	0	0	0	0	-
0			-	0	0	0.28	1.26	1.18	0	0		1.42	1.25	1.11
0	0		0	0	0.82	0.82	0	0	0.76	0.68	0.58	0	0	0
0	0	0	0	0	1.92	1.64	0	0	1.52	1.34	1.19	0	0	0
5 97 7	505\$	51.72	50.51	50.60	50.68	5068	5064	50.59	50.64	50.64	504	.50.59	50.59	5059
49.16	47.44	41.38	47.44	4 7.0 0	46.58	46.58	4684	47.05	46.84	4 4.8 4	46.84	47.05	47,05	47.05
25	0 54	58	****9 o	** 0	103	113	9125	0,127	164	0,165	*39°	184	0185	*9810

\* 印位比較用試料 o 印は Tra につっての最適合有値を示す。

2 1

				22
O 34	. 0.49	0.029	9 × 10 <sup>10</sup>	830
3.8	0.13	0.015	1 × 1 0 1 1	1000
4 2	0.13	0.091	1×10 <sup>11</sup>	1000
2 44	0.41	0.027	1 × 10 <sup>11</sup>	920
48	0.16	0.030	1×10 <sup>11</sup>	940
5 2	0.14	0.074	9×10 <sup>10</sup>	1.050
° 54	0.36	0.026	1 × 10 <sup>11</sup>	870
58	0.12	0.025	1 × 10 <sup>11</sup>	1100
O 64*	0.25	0.026	1 × 10 <sup>11</sup>	700
O 74*	0.22	0.030	1 × 10 <sup>11</sup>	. 680
0 103	0.53	0.028	1 × 10 <sup>11</sup>	790
O 113	0.50	0.033	9 × 10 <sup>10</sup>	940
0 125	0.48	0.035	1×10 <sup>10</sup>	810
<sup>0</sup> 127	0.47	0.029	8 × 10 <sup>10</sup>	860
O 164	0.50	0.026	8 × 10 <sup>10</sup>	920
O 165	0.33	0.029.	1×10 <sup>11</sup>	850
2.166*.	0.24	0.0 3 2	7 × 10 <sup>10</sup>	720
184	0.40	0.030	7 × 10 <sup>10</sup>	980
185	0.31	0.026	1×10 <sup>11</sup>	950
<sup>2</sup> 186*	0.22	0.029	1×10 <sup>11</sup>	700

- \*印は比較用試料
- o印はLn の最適組成比を示す。

	第	3	表	21
武料		コンデン	サ特性	
番号	C (#F/cml)	tan 8	IR (Q)	V <sub>b</sub> (V)
1*	0.05	0.124	1 × 10 11	900
2	0.14	0.079	1 × 10 11	870
3	0.29	0.053	9 × 10 10	850
4	0.43	0.034	1 × 10 11	800
° 5	0.5 4	0.025	8 × 10 10	820
6	0.38	0.020	8 × 10 10	900
7	0.24	0.019	8 × 10 <sup>10</sup>	900
8	0.17	0.018	1 × 10 11	950
9*	0.08	0.022	1 × 10 11	980
11*	0.0 4	0.111	7 × 10 10	820
12	0.16	0.068	9×10 <sup>10</sup>	800
0 1 4	0.40	0.024	1×10 <sup>11</sup>	900
18	0.12	0.017	1×10 <sup>11</sup>	930
19*	0.09	0.023	1 × 10 11	800
21*	0.0 8	0.108	7 × 10 10	740
22	0.17	0.080	1×10 <sup>11</sup>	820
0 2 4	0.5 6	0.029	1 × 10 11	800
28	0.16	0.021	1×10 <sup>11</sup>	830
29*	0.07	0020	1 × 10 11	800
3 2	0.18	0.077	9 × 10 10	930

試料1,11,21はLn の含有量がいずれも O.67 モル系未満であり、それぞれの面積容量 C はいずれも 0.1 μP/cd未満と小さいので、本発明 の範囲外とした。また試料9,19,29はLn の含有量がいずれも 6.90 モルダを越えており、 それぞれの面積容量 CはいずれもO.1 μF/cm未満 と小さいので、本発明の範囲外とした。一方、試 料 6 4 , 7 4 , 1 6 6 , および 1 6 8 は面積容量 がいずれもO.1 μF/cn以上あるが、Ln の含有量 および製造処理条件は最適であるにもかかわらず O.27 μ F/cml 以上の面積容量(絶縁破壊電圧が 750~850Vのレベルで)得られないので、本発 明の範囲外とした。すなわち、La あるいはCe の含有量が全希土類元素含有量の20原子もを越 えると(試料 166, 168)、本発明の範囲外とな る。

#### 実施例2

実施例1と同様のBaCO<sub>3</sub>粉末,TiO<sub>2</sub>粉末,Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>粉末,Pr<sub>8</sub>O<sub>11</sub>粉末,Sm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>粉末,Gd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>粉末を用いて、試料番号103,同125,

および同ちの組成比になるように配合し、さらに とれらの3種類の組成に対して、市販の試薬特級 MnO2, Fe2O3, NiO, Cr2O3, CoO および SiO2の各粉末それぞれ下記の第4表の組成比に なるように添加,配合し、以下実施例1と同様の 製造工程, 処理条件によりコンデンサ素子を作製 し、実施例1と同様の各種測定をした。その結果 を第5表に示す。また直流バイアス電圧印加によ る静電容量の減少率を測定した結果を図に示す。 図における符号は試料番号を示している。とこで 電圧印加による静電容量の減少率  $^{4C}/_{C}$  は、

$$\frac{dC}{C} = \frac{C_{1V} - C_{x}}{C_{1V}} \times 100 \qquad (\%)$$

より求めた。 C<sub>1V</sub> は直流 1 V 印加時の静電容量 で C<sub>x</sub> は直流 x V 印加時の静電容量である。

(以下余白)

26

25

	1	FEE :	器相		<del></del>		
試料	BaO, TiO, NdO3/2			原子	- 95		
番号	PrO <sub>11/6</sub> , SmO <sub>2/7</sub> , GdO <sub>3/2</sub> の各配音組成	MnO <sub>2</sub>	FeO <sub>5/2</sub>	NiO	CrO <sub>3/2</sub>	c.0	S102
201		0.5	0	0	0	0	0
202		, 1.0	0	0	0	0	0
204		2.0	0	0	0	O	0
206	試料番号	4.0	0	0	0	0	0
207	103の組成	5.0	0	0	0	٥	. 0
208*	(第2表参照)	5.5	0	٥	0	0	. 0
215		2.0	0.5	0	0	0	0
216		2.0	0	0.5	0	0	0
217		2.0	. 0	0	0.5	0	0
218		2.0	0	O	0	0.5	0
231		0	0.5	0	0	0	0
232	[	0	1.0	0	0	0	0
234		0	2.0	0	0	0	0
236		0	4.0	0	0	0	0
237	試 料 番 号	0	5.0	0	0	0	0
238*	125の組成	0	5.5	0	0	0	0
245	(第2表参照)	0.5	2.0	0	0	0	0
246		0	2.0	0.5	0	0	0
247		0	2.0	0	0.5	0	0
248		Ò	2.0	0	0	0.5	0

262		0	0	0	0	0	0.5
264		0	. 0	0	0	0	1,0
266	ê+ &1 ±07. €3	0	0	0	0	0	2.0
267*	試料番号 5の組成	0	0	0	0	0	2.5
272	(第2表参照)	2.0	0	0	0	0	0.5
274	•	2.0	0	0	0	0	1.0
282		0	2.0	0	0	0	0.5
284		0	. 0	0	2.0	0	0.5

\* 印は比較用試料

		第 5	表	
試料		コンデ	ンサ特性	
番り	C ("FAN)	tanð	IR (Q)	V <sub>b</sub> (V)
201	0.52	0.026	1 × 10 <sup>11</sup>	820
202	0.47	0.024	1×10 <sup>11</sup>	910
204	0.43	0.021	1 × 10 <sup>11</sup>	950
206	· Q35	0.029	1×10 <sup>11</sup>	1000
207	0.31	0.047	2×10 <sup>11</sup>	1100
208	0.15	0.128	2 × 10 <sup>11</sup>	1 2.0 0
215	0.4 1	0.022	1 × 10 <sup>11</sup>	1000
216	0.38	0.025	1×10 <sup>11</sup>	1000
217	0.42	0.030	1 × 10 <sup>11</sup>	1000

218	0.35	0.0 2 0	1 × 10 <sup>11</sup>	1100
231	0.49	0.033	8 × 10 10	890
232	0.47	0.029	9 × 10 10	970
234	0.3 9	0.023	9 × 10 10	1000
236	0.3 3	0.035	1 × 10 <sup>11</sup>	1000
237	0.2 8	0.056	1 × 10 <sup>11</sup>	1100
238*	0.17	0.143	2 × 10 <sup>11</sup>	1200
245	0.40	0.023	1×10 <sup>11</sup>	970
246	0.3 6	0.028	1×10 <sup>11</sup>	1000
247	0.38	0.035	1×10 <sup>11</sup>	1000
248	0.3 6	0.0 5 1	1 × 10 <sup>11</sup>	1000
262	0.5 1	0.021	9×10 <sup>10</sup>	860
264	0.47	0.018	1 × 10 <sup>11</sup>	930
266	0.3 1	0.016	1 × 10 <sup>11</sup>	1000
267*	0.16	0.015	2 × 10 <sup>11</sup>	1200
272	0.3 5	0.023	1×10 <sup>11</sup>	1000
274	0.3 4	0.020	1×10 <sup>11</sup>	1100
282	0.3 6	0.030	1 × 10 <sup>11</sup>	1000
284	0.29	0.019	1 × 10 <sup>11</sup>	1100

#### \* 印は比較用試料

試料 208,238 はそれぞれMn,Fe の含有量が 5原子男を越えており、いずれも面積容量は

X<sub>0.0001</sub> O<sub>3/2</sub> )が2.74 モル多の組成比にな るように配合し、さらにとの組成に対してMnOっ を2.0原子多添加した配合物を、ポットとめのう 玉石を用いて湿式混合し、乾燥した後、1150℃ の温度で4時間仮焼したoとの仮焼物を湿式粉砕 し、乾燥した。なお上記混合、粉砕過程における めのう玉石からのSi成分の混入量を知るため、 上記仮焼・粉砕・乾燥粉末の一部分を採取し、定 量分析を行なった結果、Siの混入量はO.3原子 **豸であることが判明した。次に、上記仮焼後の粉** 砕・乾燥粉末をポリビニールアルコール水溶液 (濃度5%)をパインダーにして混合し、32メ ッシュパスに整粒したo この整粒粉を、直径13 扁,厚み O.5 扁の円板形に約1トン/cmiの加圧力で 成形した。 との成形体を空気中にて1200~1450 での範囲内の温度で2時間焼成した。このとき、 1250℃よりも低い温度ではこの成形体が十分に 焼結しなかった。 これに対して1250~1450C の範囲内の温度で焼成したものは直径約10.5 ㎜, 厚さ約0.4 mmの緻密な(水含浸法による気孔率測

O.27μF/cd 以下と小さく、 tan 8 は O.1 以上と大きいので、本発明の範囲外とした。一方、試料 267 は Si の含有量が 2 原子 8 を越えており、 面積容積が O.27μF/cd 以下と小さいので、本発明の範囲外とした。また Mn, Fe, Ni, Cr, および Co の酸化物を添加したものは、図に示すように添加しないものに比べて面積容量の電圧依存性が改善され、印加電圧を取り去った時の容量は元の値(直流 1 V 印加時の容量値)に、瞬時にして 復帰した。

#### 実施例3

**第 6 表** 

試料番号	焼結温度 (で)	気孔率 (%)	比抵抗 (Q•cm)
301	1250	2.1	2 × 10 <sup>12</sup>
302	1275	1.7	1 × 10 <sup>12</sup>
503	1300	1. 0	8×10 <sup>11</sup>
304	1325	0.9	8 × 10 <sup>11</sup>
305	1350	0.9	7 × 10 <sup>11</sup>
306	1400	1, 1	4×10 <sup>11</sup>
307	1450	1.5	3×10 <sup>11</sup>

次に、このようにして得られた誘電体磁器それぞれを、 $755N_2-255H_2$ 混合ガス気流中にないて $800\sim1300$ で の範囲内の温度で2時間加熱処理し、得られた磁器の両面にIn-Ga 電板を途布しその比抵抗を測定した。その結果を第7表に示す。

	217 .	20.	
試料番号	使用した試料 番号(第6表)	熱処理温度(c)	比抵抗 (Q•cm)
402*	302	850	130
404*	304	850	8 6
406*	306	850	100
412	302	900	6.3
414	304	900	5.1
416	306	.9 0 0	5.5
442	302	1050	1. 9
444	304	1050	1.6
446	306	1050	1.5
462	302	1150	1. 1
464	304	1,150	.0.92
466	306	1150	1.0
472	302	1250	0.84
474	304	1250	0.66
476	. 306	1250	0.79
492	302	1300	. 0.77
494	304	1300	0.63
496	306	1300	0.81

#### \*印は比較用試料

33...

Ŗ	8	表

		舞	<b>3 8 表</b>			
試料	使用した	熱処理	コンデンサ特性			
番号	試料番号 (第7表)	温度(C)	C (µF/cm)	tan 8	IR (Q)	V <sub>b</sub> (V)
1444*	4 4 4	750	1.2	0.235	3 × 10 4	40
1464*	464	750	1.3	0.341	4 × 10 4	5.0
1494*	494	750	1.5	0.442	2 × 10 <sup>3</sup>	20
2444	444	800	0.63	0.070	8 × 10 9	400
2464	464	800	0.7 1	0.061	8 × 10 9	550
2494*	494	800	1.2	0.249	4 × 10 <sup>3</sup>	. 20
3444	444	900	0.60	0.045	8 × 10 <sup>10</sup>	680
3464	464 .	900	0.58	0.047	1 × 10 <sup>11</sup>	590
3494*	494	900	1.4	0.510	5 × 10 <sup>3</sup>	20
5444	444	1000	0.57	0,027	1 X,10 <sup>11</sup>	860
5464	464	1000	0.58	0.031	1 × 10 <sup>11</sup>	820
5494*	494	1000	1.8	0.311	7 × 10 <sup>3</sup>	3.0
7444	444	1100	0.46	0.033	1 × 10 <sup>11</sup>	900
7464	464	1100	0.42	0.026	1 × 10 <sup>11</sup>	1000
7494*	494	1100	1.3	0.379	1×10 <sup>4</sup>	30
8444	444	1200	0.17	0.019	1 × 10 <sup>11</sup>	1000
8464	464	1200	0.2.1	0.024	1 × 10 <sup>11</sup>	1100
8494*	494	1200	1.6	0.254	2 × 10 <sup>3</sup>	20
9444*	4 4 4	1250	0.03	0.058	1 × 10 <sup>11</sup>	1200
9464*	464	1250	0.05	0.047	1 × 10 <sup>11</sup>	1200
9494*	494	1250	1.5	0.397	3×10 4	30

\* 印は比較用試料

試料 402,404,406は比抵抗がそれぞれ130 Q·cm, 8 6 Q·cm, 100Q·cm と高く、酸素イオン 空孔型半導体化が不十分であった。 したがって、 選元性雰囲気中での熱処理温度が BOOC未満の低 い温度域については本発明の範囲外ととした。他 の試料はすべて比抵抗が低く十分に半導体化され ていた。

さらに、このようにして得られた酸素イオン空 孔型半導体磁器を、酸素気流中において700~ 1300℃の範囲内の温度で加熱処理して得た磁器 の両面に銀電板を焼き付けてコンデンサ累子とし、 そのコンデンサ特性、すなわち面積容量 C (1kHz) ,誘電損失 tan & (1kHz),絶縁抵抗 IR (直 流  $6 \ O \ V$  ),絶縁破壊  $V_b$  を削定した。その結果 を第8表に示す。

(以下余白)

第8表において、試料1494,2494,3494, 5494,7494,8494,9494 は、焼結後の還元 性界囲気処理工程において1300℃で加熱して得 た試料で、酸素の体積拡散がほとんど起らないた め表面誘電体層が形成されず、絶縁破壊電圧はい ちぢるしく低く(50V以下)、実用に耐えないo とのように、意元性雰囲気中での熱処理温度が 1250℃を越えると好ましくないので、1250℃ より高い温度域については本発明の範囲外とした。 また、試料9444,9464 については、酸化性祭 朗気中での熱処理温度が1250c と高すぎて再酸 化容量が小さい。このため酸化性雰囲気中での熱 処理温度については、1200°を越える温度域を 本発明の範囲外とした。 試料 1444,1464 は酸 化性雰囲気中での熱処理温度がBOOCより低いた め、十分に再酸化されていず、そのため表面誘電 体層の厚みが薄く、絶縁破壊電圧が100V以下と 低く、実用に耐えない。上記以外の試料は、すべ てΟ.1 μΕ/cm 以上の非常に大きい面横容量をも ち、かつ 500V以上の高い破壊電圧をもっており、

本発明の目的を満足するものである。

### 4、図面の簡単な説明

図は代表的な試料の印加電圧と面積容量の減少 率との関係を示す。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

